

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）第三届董事会第二十四次会议于2020年3月16日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2020年3月12日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款展期的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟将与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签署的合同编号为YYB9210120190021的流动资金贷款申请展期，金额为人民币5,000万元，期限1年。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。

为便于公司向华夏银行申请展期工作进行顺利，董事会同意授权公司董事长王立群先生在董事会审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年3月16日